Pâte à souder NP303-MF155-GQ

GENMA EUROPE

Description du produit

GENMA pâte à souder CMS - Notre NP303-MF155-GQ est facile à imprimer, a une durée de vie suffisante sur le pochoir et une bonne adhérence lors de l'assemblage. Le bon mouillage garantit des résultats de soudage constants. Il n'est pas nécessaire de nettoyer après le soudage. La pâte à souder peut être soudée sous air ou sous gaz inerte. La pâte à souder convient très bien pour les distributeurs grâce à une thixotropie élevée.

Propriétés techniques

	Valeur spécifique	Méthode d'essai
Alliage (wt %)	Sn 96,5 / Ag 3,0 / Cu 0,5 / SAC305	
Plage de fusion (°C)	217 - 221	IEC61189-11
Taille de la poudre (µm)	22 - 38, type 4	IPC-TM-650-2.2.14.2
Viscosité (Pas)	190 ± 20	IPC-TM-650-2.4.34.3
Teneur en flux (%)	11,0 ± 0,3	IPC-TM-650-2.3.34.1
Type de flux	ROL1, no clean	IPC-J-STD-004B
Grille d'application (mm)	0,4	
Teneur en halogène (%)	0,04 ± 0,02	IPC-TM-650-2.3.35
Fonctionnement à l'impression (mm)	≤ 0,2	IPC-TM-650-2.4.35
Fonctionnement à l'impression (mm)	≤ 0,3	IPC-TM-650-2.4.35 (180°C / 60sec)
Résistance d'isolation (Ω)	40°C 90 % r. L ≥ 1 x 10^{12} Ω	IPC-TM-650-2.6.3.3
Résistance d'isolation (Ω)	85 °C 85 % r. L ≥ 5 x 10^{8} Ω	IPC-TM-650-2.6.3.3
Test de migration	Pas de migration	IPC-TM-650-2.6.14.1
Test de niveau de cuivre	Pas de corrosion	IPC-TM-650-2.3.32
Unité d'emballage	Dose (0,5 kg) cartouche Semco (0,65 kg, 1,2 kg) cartouche EFD (10 ccm avec 30 g)	
Durée de conservation minimum	6 mois à 0 - 10 °C	
Transport	refroidi	
Trempe de la pâte à souder	Amener à température ambiante à temps avant ouverture pour éviter la condensation.	
Vitesse d'impression recommandée (mm/s)	20 - 80	
Température recommandée lors de l'impression (°C)	25 ± 3	
Humidité relative recommandée en % à l'impression	50 ± 20	

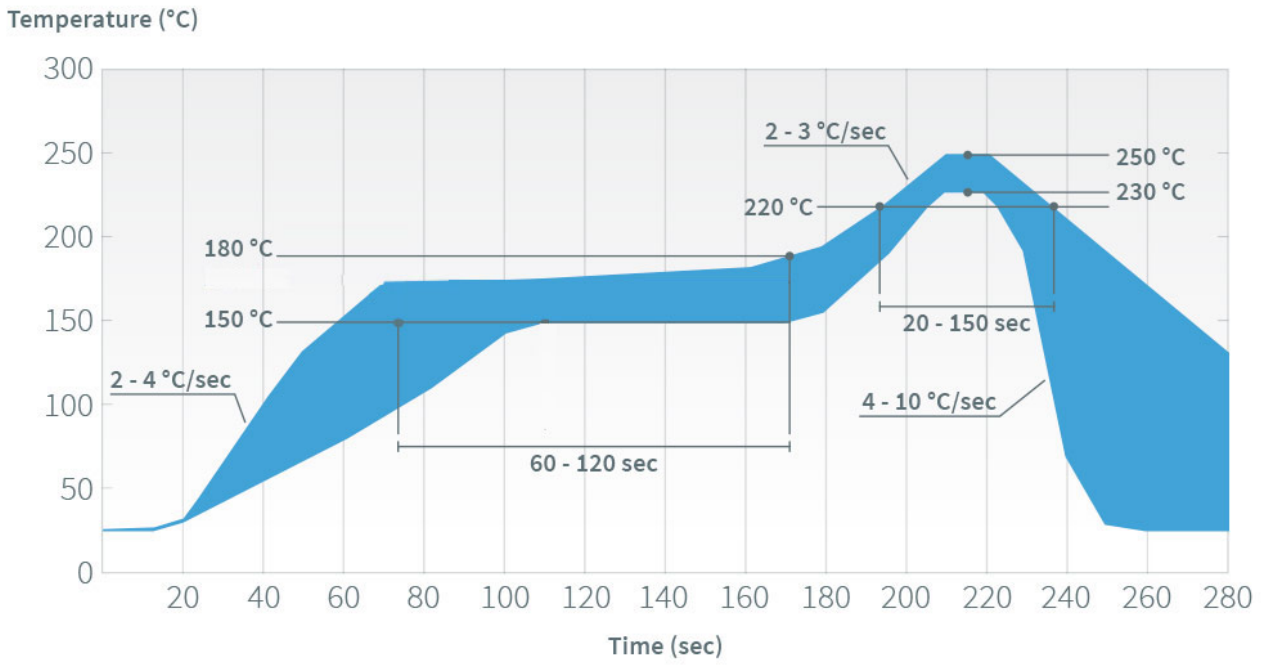
Conformité

Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU et annexe 2015/863/EU

Ne contient aucune substance supérieure à la valeur limite (0,1 %) conformément au règlement REACH CE n°.

GENMA Europe GmbH | Robert-Bosch-Str. 18 | 71394 Kernen i. R. Germany | Phone +49 7151 206610 | team@genma.eu | www.genma.eu

Profil de flux recommandé



Préchauffage

L'élévation de la température jusqu'à la zone de préchauffage devrait être de 2 – 4 °C/seconde. Un accroissement trop rapide de la température peut conduire à une dispersion de la pâte à souder.

Dans un but d'atteindre une dissémination aussi réduite que possible de la température (⊿t) sur la plaquette de circuit imprimé, la température dans la zone de préchauffage devrait être de 150 – 180 °C et la durée de préchauffage de 60 à 120 secondes. En cas de température inférieure et de durée plus réduite, la dissémination de la température (⊿t) sur la plaquette de circuit imprimé est trop importante. En cas de température supérieure et de durée plus importante, les activateurs sont perdus, ce qui peut conduire à ce que la pâte à souder ne fonde pas.

Pic de reflux

Nous vous recommandons de maintenir dans la mesure du possible la température au-dessus de 220°C pendant 20 – 150 secondes. Si ceci n'est pas possible, une température jusqu'à 250°C peut être maintenue sur une durée plus courte. Il est nécessaire dans ce contexte de s'assurer que les éléments de construction soient adaptés à la haute température.

Refroidissement

La vitesse de refroidissement devrait se trouver entre 4 – 10°C/seconde. Un refroidissement trop lent peut conduire à un glissement ou un redressement des éléments de construction et réduire l'épaisseur de la connexion soudée. Un refroidissement au contraire trop rapide peut endommager les éléments de construction par un choc thermique.